

模組副工程師

徵才條件

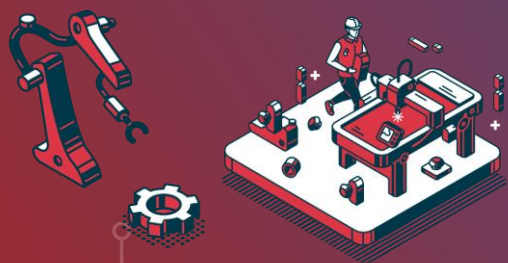
- 具備大學學歷，且為電機、電子、機械、自動控制、冷凍空調工程等相關科系
- 需有機械相關的基礎知識；有半導體製程知識者尤佳
- 具備問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習等能力
- 具備基本英文讀寫能力
- 能配合大多數工作時間內，穿著無塵衣且將在無塵室環境中工作

工作內容

- 負責半導體產品線機台設備維修及保養
- 管理及改善機台零件系統、包含廠商與下包商之零件備品管理
- 設計機台保養制具及流程改善以增進機台穩定性
- 需配合日、夜/假日班輪值(約每四週輪值一次大夜班，一次輪值六天)

福利制度

- 起薪36,000起
- 含分紅獎金、大夜津貼、額外獎金
- 含勞保、健保、團保



*IC The FUTURE,
Together WE define the future*